

Wafer Auto Inspection Machine (OM)



技術規格

外型尺寸：	1200 (L) mm*1200 (W) mm*1800 (H)mm
重量：	1750 KG
WPH:	抽檢時間：WPH $\geq$ 100 (8吋晶圓 9*4=36點) 全檢時間：WPH $\geq$ 30 (8吋晶圓 base on 30 μ m)

設備特性與優點

全自動晶圓檢查機(OM)能協助客戶檢測如裂痕、缺角、 Particle、 變色、刮傷、髒污，最低至3μm以上的瑕疵，而能檢測晶圓尺寸範圍為8~12吋晶圓。

- 可因應不同產品更換或新增檢測項目。
- 上片後有晶圓對位機制。
- 自動尋邊功能可對應翹曲 $\pm 2\text{mm}$ 之晶圓。
- 影像辨識成功率高。
- 可結合上游測試機晶粒資料，合併後上傳至下一道製程設備。
- 達到次微米需求的高速檢測除震平台。